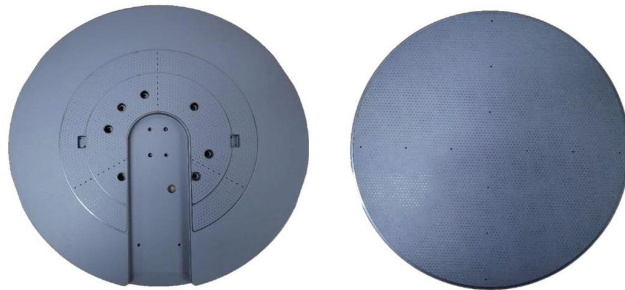


真空吸盘

产品描述

格物光学半导体的高性能真空吸盘系列主要应用于半导体光刻以及各种量检测设备中，如膜厚测量，OCD测量，形貌测量，缺陷检测等。吸盘采用轻量化设计，并采用和硅材料热膨胀系数相近材料：无压烧结碳化硅，渗硅碳化硅，氮化硅和氮化铝等。吸盘具备高刚度，高导热，低热膨胀，稳定性高等特点，另外，还具备高纯度，晶粒大小均匀等特性，如此可有效的减少Particle以及化学清洗的污染问题，延长使用寿命。



产品特点

- 高导热性、低膨胀系数
- 良好的平面度
- 高刚度，更优异的耐磨性
- 轻量化设计
- 高纯度，无金属离子污染
- 可根据用户需求进行结构定制

应用

- 半导体光刻
- 半导体量检测

参数

参数	指标
平面度/Flatness	0.2 μ m
适用规格/Specifications	6/8" 12" 8/12"
表面特征/Surface Feature	凸点式，沟槽式
Pin高度/Pin Hight	0.05-0.2mm
Pin直径（最小）/Pin Minimum Diameter	\varnothing 0.2mm
pin间距（最小）/Minimum spacing	3mm
密环宽度（最小）/Minimum Seal Width	0.7mm
表面粗糙度/Surface Roughness	Ra 0.02
厚度公差/Thickness Tolerance	\pm 0.01mm
直径公差/DiameterTolerance	\pm 0.01mm
平行度公差/Parallelism Tolerance	\leq 3 μ m